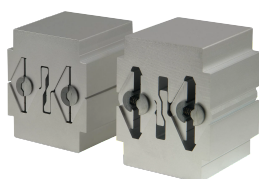


Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 70 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-ipcprocessors and AMD processors with the following sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366,LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Compatible with Interscale C enclosures

Provides industry leading conduction cooling performance, 70% improvement over current conduction cooling methods

Conductor block expands/contracts vertically to compensate fortolerance stack up and optimizes surface contact and pressurealong the thermal path; eliminates the need for a thermal gappad

Secured to PCB with mounting brackets, sold separately

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo	Works With	Quantidade por embalagem	Profundidade	Largura
--------------------	------	------------	--------------------------	--------------	---------

24830-001	Heat Conductor	Cases	1	50 mm	50 mm
-----------	----------------	-------	---	-------	-------

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order the mounting bracket (Intel or AMD, listed under accessories) to assemble the FHC to the board.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE